附件三

《芯片生产厂房微振动控制工程技术规范》征求意见表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 职务 |  | 单位 |  |
| 联系电话 |  | 邮政编码 |  | 通信地址 |  |
| E-mail |  | 传真 |  |
| 序号 | 条文编号 | 原条文 | 修改意见 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（纸面不敷，可另增页）

联 系 人： 吕佐超、刘影

联系电话：13681287707、13810259850

通信地址：北京市海淀区西四环北路160号

电子邮箱：lvzuochao@sdic.com.cn，liuying002@sdic.com.cn